

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2026-001

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参与单位名称/人员姓名	中信证券
时间	2026 年 1 月 19 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p>Q1、公司液冷产品目前向台湾厂商提供的具体有哪些？</p> <p>答：公司液冷业务目前已形成多款产品序列。主要提供不锈钢波纹管及配套组件，目前也已为台湾客户提供液冷板相关部件，并协助其进行焊接与工艺验证等。</p> <p>Q2、公司液冷业务的具体发展规划如何？</p> <p>答：根据公司于 2026 年 1 月 17 日披露的《2026 年度向特定对象发行A股股票预案》，公司拟投入 3.62 亿元建设液冷散热系统产业化项目，拟投入 1.14 亿元用于液冷研发中心及集团信息化建设项目。目前公司液冷业务处于积极市场拓展阶段，营收规模尚小，但公司正积极推进与多家头部客户的样品测试与量产导入。在海外客户拓展方面，公司已通过台湾合作伙伴进入美系头部半导体公司供应链，同时公司与AI基础设施解决方案提供商SuperX在新加坡设立了合资公司，</p>

	<p>共同拓展海外液冷市场。在境内业务方面，公司已与国内头部服务器厂商开展深度合作并积极拓展互联网企业。</p> <p>Q3、公司液冷业务是否已进入主流供应链体系？</p> <p>答：公司已通过台湾客户进入美系头部半导体公司供应链，为其提供冷板、管路等零部件，并根据客户需求提供多种产品形态，如不锈钢波纹管、Inner Manifold等，同时公司也正积极配合其推进适配开发下一代的MLCP。在国内市场，公司目标是通过认证进入更多服务器厂商的合格供应商名单。</p> <p>Q4、半导体封装材料业务的主要客户与发展情况如何？</p> <p>答：公司半导体封装材料业务广泛涉及MOSFET、IGBT、SiC等IGBT功率模块的封装材料供应。2024 年相关产品收入占总营收比例近 10%，2025 年该业务仍然保持强劲增长态势。主要客户包括国内知名的功率半导体封装企业，同时也在推进整车厂车规级封装项目。产品主要应用于光伏逆变、储能及新能源汽车领域。</p> <p>近年来，半导体封装材料国产化趋势叠加下游行业应用增长，相关产品市场需求持续旺盛，公司拟新增引线框架及高导热铜针式散热底板等产品产能，持续提升公司在高端封装材料领域的技术水平和国产化配套能力，把握进口替代和产业升级带来的结构性发展机遇。</p> <p>Q5、智能卡业务现状如何？</p> <p>答：近年来，随着移动支付的普及，实体智能卡步入存量阶段，但在全球范围内，涉及身份认证、金融安全及万物互联的领域，智能卡的需求依然刚性。智能卡业务作为公司传统优势板块，营收规模稳定，其中国外市场占比较高、现金流稳定。随着eSIM等技术推广，公司正推动该业务向服务方向升级，以提升毛利水平。整体上智能卡业务将维持现有规模，未来投入将更加聚焦于半导体封装材料和液冷散热业务。</p>
风险提示	<p>公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与</p>

	保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2026-1-19